



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232047
CG-DL-E-21122021-232047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 2021/अग्रहायण 30, 1943

No. 374]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 2021/AGRAHAYANA 30, 1943

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आई पी एच डब्ल्यू विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

विषय : भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर / सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी) / ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना

फा. सं. डब्ल्यू-38/23/2021-आई पी एच डब्ल्यू.—1. पृष्ठभूमि

- 1.1. इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है। सेमीकंडक्टर पिछले 50 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिकी की उन्नति में एक प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं और आईओटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5जी, स्मार्ट कारों, स्मार्ट कारखानों, डेटा केंद्रों, रोबोटिक्स आदि सहित नए अनुप्रयोगों की शुरुआत के साथ और भी बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे।
- 1.2. सेमीकंडक्टर निर्माण एक जटिल और अनुसंधान-गहन क्षेत्र है, जिसे प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव द्वारा परिभाषित किया गया है जिसके लिए महत्वपूर्ण और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में, एकीकृत सर्किट (आईसी) और असतत सेमीकंडक्टर उपकरणों का उत्पादन वेफर फैब्रिकेशन सुविधा में किया जाता है, जिसे आमतौर पर फैब के रूप में जाना जाता है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के केंद्र में हैं और सामग्री के बिल (बीओएम) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- 1.3. हाल के वर्षों में कंपाउंड सेमीकंडक्टर बाजार में तेजी से वृद्धि देखी गई है। सेमीकंडक्टर उद्योग में बढ़ती मांग और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना, बाजार के विकास को चलाने वाले प्राथमिक कारकों में से एक है। इसके

अलावा, बिजली सेमीकंडक्टर, रेडियो आवृत्ति उपकरणों और एलईडी अनुप्रयोगों में कंपाउंड सेमीकंडक्टर के तेजी से बढ़ते उपयोग से कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की मांग और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स उच्च ऊर्जा दक्षता के साथ उच्च शक्ति पर तेजी से स्विचिंग प्रदान करते हैं और उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं।

- 1.4. सिलिकॉन फोटोनिक्स के पास लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर (₹7,500 करोड़) के वैश्विक बाजार के साथ हाई-स्पीड इंटरनेट, हाई-स्पीड कंप्यूटिंग आदि में बढ़ते अनुप्रयोग हैं। 2025 तक लगभग 23% की सीएजीआर से बढ़कर 3 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹22,500 करोड़) होने का अनुमान है। सिलिकॉन फोटोनिक्स प्रौद्योगिकी आधारित डेटा केंद्रों की बढ़ती मांग सिलिकॉन फोटोनिक्स बाजार के विकास को चलाने वाला प्रमुख कारक है। इसी तरह, भारतीय माइक्रोइलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स (एमईएमएस) बाजार में तेजी से बढ़ते स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक वाहनों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों के कारण भविष्य में महत्वपूर्ण वृद्धि का साक्षी बनने की ओर अग्रसर है।
 - 1.5. सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, जिसे असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) या आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्टिंग (ओएसएटी) के रूप में जाना जाता है, चिप निर्माण प्रक्रिया में एक आवश्यक चरण है। सेमीकंडक्टर निर्माण के बाद सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एटीएमपी अगला कदम है। एटीएमपी इकाइयों को मजबूत फैब लिंकेज के साथ जोड़ा गया है और एटीएमपी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण से भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के सरकार के प्रयासों में तेजी आई। एटीएमपी क्षमताएं इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की चाह में देश में सेमीकंडक्टर्स की उपलब्धता में भी सुधार करेंगी।
 - 1.6. इलेक्ट्रॉनिकी राष्ट्रीय नीति 2019 (एनपीई 2019) का दृष्टिकोण भारत को इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना और उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। सेमीकंडक्टर फैब सुविधाओं की स्थापना और चिप्स और चिप घटकों के डिजाइन और निर्माण के लिए इसके इको-सिस्टम को सुविधाजनक बनाना, एनपीई 2019 की मुख्य रणनीतियों में से एक है।
2. **उद्देश्य:** इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और इन फैब्रिकेशन और पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग क्षेत्रों में एक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला स्थापित करने में मदद करने के लिए देश में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब्स और सेमीकंडक्टर एटीएमपी /ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करना।

3. पात्रता और भारत सरकार से वित्तीय सहायता

3.1. कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब

विवरण	उच्च आवृत्ति/उच्च शक्ति/ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों के विनिर्माण के लिए भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब स्थापित करने का प्रस्ताव देने वाली कंपनियां / संयुक्त उद्यम	
प्रौद्योगिकी	वेफर आकार	क्षमता
	150/200 मिमी या अधिक	500 या अधिक वेफर स्टार्ट / माह (100 मिमी समक्ष में)
परिचालनरत अनुभव	आवेदक कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों के पास निम्नलिखित अनुभव होना चाहिए: क. एक वाणिज्यिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब का स्वामित्व और संचालन। या ख. प्रस्तावित फैब के लिए स्वामित्व या अधिकार प्राप्त लाइसेंस प्रक्रिया सम्बंधी प्रौद्योगिकियां।	
पूंजी निवेश सीमा	कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब के लिए ₹100 करोड़ (₹1 बिलियन) का न्यूनतम पूंजी निवेश	

भारत सरकार से राजकोषीय सहायता	पूंजीगत व्यय का 30%
-------------------------------	---------------------

3.2. सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी) / आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा

विवरण	भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) / आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव देने वाली कंपनियों / संयुक्त उद्यम
परिचालनरत अनुभव	आवेदक कंपनी / संयुक्त उद्यम के पास निम्नलिखित अनुभव होना चाहिए: क. एक वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का स्वामित्व और संचालन या ख. प्रस्तावित सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई के लिए लाइसेंस प्राप्त प्रौद्योगिकियों का स्वामित्व या अधिकार रखना और लाइसेंसिंग या विकास के माध्यम से उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों के लिए रोडमैप प्रदर्शित करना
पूंजी निवेश सीमा	₹50 करोड़ का न्यूनतम पूंजी निवेश (₹500 मिलियन)
भारत सरकार से राजकोषीय सहायता	पूंजीगत व्यय का 30%

4. वित्तीय सहायता

- 4.1. **राजकोषीय सहायता :** यह योजना भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी / ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय का 30% राजकोषीय सहायता प्रदान करेगी।
- 4.2. राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी या स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, का भी लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि, इस योजना के तहत एक आवेदक को *सेमीकंडक्टर फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स फैब और एटीएमपी श्रेणी* के तहत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के तहत इंसेटिव का लाभ नहीं मिलेगा।

5. मांग एकत्रीकरण समर्थन

भारत में स्थापित कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेंसर फैब और एटीएमपी / ओएसएटी इकाइयों को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) आदेश 2017 के तहत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद में खरीद वरीयता के माध्यम से समर्थित किया जाएगा।

6. अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए सहायता

योजना के परिव्यय का 2.5% तक भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और एटीएमपी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

7. पूंजीगत व्यय

योजना के उद्देश्य के लिए "पूंजीगत व्यय" में भवन निर्माण, साफ कमरे, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं (प्रयुक्त / पुराने / नवीनीकृत सहित) प्रौद्योगिकी की लागत सहित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (टीओटी); और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पर किए गए व्यय शामिल होंगे। पूंजीगत व्यय की पात्रता के बारे में विवरण योजना दिशानिर्देशों में उपलब्ध कराया जाएगा।

8. योजना का कार्यकाल

यह योजना शुरू में एक जनवरी, दो हजार बाईस (01/01/2022) से शुरू होकर तीन साल की अवधि के लिए आवेदनों के लिए खुली होगी।

9. शासन तंत्र

9.1. नोडल एजेंसी : यह योजना एक नोडल एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।

9.2. इस तरह की नोडल एजेंसी आवेदनों की प्राप्ति, योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के वित्तीय और तकनीकी मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगी; योजना को लागू करेगी और समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य उत्तरदायित्वों को पूरा करेगी। नोडल एजेंसी के कार्यों और जिम्मेदारियों को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किए जाने वाले योजना दिशानिर्देशों में विस्तृत किया जाएगा।

9.3. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए, नोडल एजेंसी *अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों पर ध्यान देगी:*

9.3.1. आवेदन प्राप्त करना, पावती जारी करना, और योजना के तहत समर्थन के लिए आवेदकों की पात्रता सत्यापित करना। जब तक नोडल एजेंसी की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आवेदन प्राप्त करेगा और आगे की प्रक्रिया को अंजाम देगा।

9.3.2. परियोजनाओं के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के साथ-साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सहित) और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के इन विशिष्ट क्षेत्रों में आवेदकों की विशेषज्ञता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाली एजेंसी / एजेंसियों या सलाहकारों को नियुक्ति करना।

9.3.3. योजना के तहत राजकोषीय सहायता और इंसेटिव के वितरण हेतु पात्र दावों की जांच करना और पात्रता के अनुसार उन्हें वितरित करना।

9.3.4. योजना की प्रगति और निष्पादन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट जमा करना।

9.4. नोडल एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उन प्रस्तावों को प्रस्तुत करेगी जिनका वित्तीय और तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया गया है और जो योग्य पाए गए हैं ताकि आवेदनों के अनुमोदन / अस्वीकृति / संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सके।

10. अनुमोदन

10.1. योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन निरंतर आधार पर किया जाएगा और योजना के तहत दी गई मंजूरी के अनुसार कार्यान्वयन जारी रहेगा।

10.2. चयनित आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाएगी और नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को सूचित किया जाएगा।

10.3. किसी भी चयनित आवेदक को ₹100 करोड़ तक प्रोत्साहन की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव होंगे। ₹100 करोड़ से अधिक प्रोत्साहन की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे।

11. संवितरण प्रक्रिया

11.1. पूंजीगत व्यय के लिए इंसेटिव आवेदन के अनुमोदन के बाद जारी किया जाएगा, बशर्ते पूंजीगत व्यय सीमा मूल्य से अधिक हो और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो।

11.2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को पूंजीगत सहायता के वितरण के लिए बजटीय प्रावधान करेगा। अनुमोदन शर्तों के आधार पर नोडल एजेंसी द्वारा संवितरण किया जाएगा। नोडल एजेंसी नियमित आधार पर समेकित राशि के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बजटीय आवश्यकता प्रस्तुत करेगी।

11.3 आवेदकों हेतु संवितरण की विस्तृत प्रक्रिया योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

12. **प्रभाव आकलन**

योजना का मध्यावधि मूल्यांकन इसके कार्यान्वयन के दो साल बाद या योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए आवश्यकता के अनुसार, स्वीकृत आवेदकों द्वारा योजना तथा अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुसार किया जाएगा। इस तरह के प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर, योजना के कार्यकाल को बढ़ाने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इसके वित्तीय परिव्यय को बदलने का निर्णय लिया जाएगा।

13. **योजना के दिशानिर्देश**

योजना के दिशा-निर्देश इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से अलग से जारी किए जाएंगे।

14. **योजना और दिशानिर्देशों में संशोधन:** योजना और उसके दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन समय-समय पर या आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा।

सौरभ गौड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2021

Subject : Scheme for setting up of Compound Semiconductors / Silicon Photonics / Sensors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) /OSAT facilities in India

F. No. W-38/23/2021-IPHW.—1. Background

- 1.1. The electronics industry is the world's largest and fastest growing industry with applications in all sectors of the economy. Semiconductors have been a key enabler in the advancement of electronics for the past 50 years and will continue to play an even greater role with the introduction of new applications including IoT, artificial intelligence, 5G, smart cars, smart factories, data centres, robotics, etc.
- 1.2. Semiconductor manufacturing is a complex and research-intensive sector, defined by rapid changes in technology which require significant and sustained investment. In the micro-electronics industry, integrated circuits (ICs) and discrete semiconductor devices are produced in a wafer Fabrication facility, commonly known as a Fab. Semiconductors are at the heart of electronic products and constitute a significant part of the Bill of Materials (BOM).
- 1.3. Compound semiconductor market has witnessed rapid growth in the recent years. Increasing demand and adoption of emerging technologies in the semiconductor industry is one of the primary factors driving market growth. Moreover, rapidly increasing use of compound semiconductors in power semiconductors, radio frequency devices and LED applications is expected to drive the demand for the compound semiconductors even higher. Compound Semiconductors provide faster switching at high power with increased energy efficiency and suitable for high temperature applications.
- 1.4. Silicon Photonics has growing applications in high-speed internet, high-speed computing etc. with a global market of nearly USD 1 Billion (₹7,500 crore). It is forecast to grow to USD 3 billion (₹22,500 crore) by 2025 at a CAGR of nearly 23%. Rising demand for Silicon Photonics technology-based data centres is the major factor driving the growth of Silicon Photonics market. Similarly, Indian Microelectromechanical Systems (MEMS) market is poised to witness significant growth in the future on account of the thriving healthcare, automation, electric vehicles and consumer electronics industries.

- 1.5. Semiconductor packaging, otherwise known as Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) or Outsourced Semiconductor Assembly and Testing (OSAT) is an essential stage in the chip manufacturing process. ATMP is the next step in the semiconductor value chain after semiconductor fabrication. ATMP units are coupled with strong Fab linkages and building ATMP ecosystem will accelerate the government's efforts to set up Semiconductor Fabs in India. ATMP capabilities will also improve availability of semiconductors in the country in the quest to become Atmanirbhar in this critical sector.
- 1.6. The vision of National Policy on Electronics 2019 (NPE 2019) is to position India as a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) and create an enabling environment for the industry to compete globally. One of the main strategies of NPE 2019 is to facilitate setting up of semiconductor Fab facilities and its eco-system for design and fabrication of chips and chip components.
2. **Objective:** To attract investments for setting up Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) Fabs and Semiconductor ATMP / OSAT facilities in the country to strengthen the electronics manufacturing ecosystem and help establish a trusted electronics value chain in the areas of application of these fabrication and packaging technologies.
3. **Eligibility and Financial Incentives from Government of India**

3.1. **Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) Fab**

Description	Companies / Joint Ventures proposing to set up Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) Fab in India for manufacturing High Frequency / High Power / Optoelectronics devices	
Technology	Wafer Size	Capacity
	150 / 200 mm or more	500 or more Wafer Starts / Month (in 100 mm equivalent)
Operational Experience	The applicant Companies / Joint Ventures should have the following experience: A. Own and operate a commercial Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) Fab or Silicon Semiconductor Fab OR B. Own or possess licensed process technologies for the proposed Fab	
Capital Investment Threshold	Minimum Capital Investment of ₹100 crore (₹1 billion) for Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) Fab	
Fiscal support from Government of India	30% of Capital Expenditure	

3.2. **Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) / Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility**

Description	Companies / Joint Ventures proposing to set up Semiconductor Assembly, Testing, Marking, and Packaging (ATMP) / Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility in India
Operational Experience	The applicant Companies / Joint Ventures should have the following experience: A. Own and operate a commercial Semiconductor Packaging Unit OR B. Own or possess licensed technologies for the proposed semiconductor packaging unit and demonstrate the roadmap to advanced packaging technologies through licensing or development

Capital Investment Threshold	Minimum Capital Investment of ₹50 crore (₹500 million)
Fiscal support from Government of India	30% of Capital Expenditure

4. **Financial Support**

- 4.1. **Fiscal support:** The scheme shall extend a fiscal support of 30% of the Capital Expenditure for setting up of Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) Fab and Semiconductor ATMP / OSAT facilities in India.
- 4.2. **Additional financial support,** if any, offered by the State Government or any of its agencies or local bodies may also be availed. However, an applicant under this Scheme will not avail incentive under the Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS) under the *Semiconductor Fab, Compound Semiconductors Fab and ATMP category*.

5. **Demand Aggregation Support**

Compound Semiconductors / Silicon Photonics / Sensors Fabs and ATMP / OSAT units set up in India will be supported through purchase preference in procurement of electronic products by the Government under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017.

6. **Support for R&D, Skill Development and Training**

Up to 2.5% of the outlay of the scheme shall be earmarked for meeting the R&D, skill development and training requirements for the development of compound semiconductors and ATMP ecosystem in India.

7. **Capital Expenditure**

“Capital Expenditure” for the purpose of the scheme shall include expenditure incurred on building, clean rooms, plant, machinery, equipment & associated utilities (including used / second hand / refurbished); transfer of technology (ToT) including cost of technology; and research & development (R&D). Details regarding the eligibility of capital expenditure shall be provided in the scheme guidelines.

8. **Tenure of the Scheme**

The scheme shall be open for applications initially for a period of Three Years starting from January One, Two Thousand and Twenty-Two (01/01/2022).

9. **Governance Mechanism**

- 9.1. **Nodal Agency:** The scheme will be implemented through a Nodal Agency.
- 9.2. Such nodal agency will be responsible for receipt of applications, carrying out financial and technical appraisal of the applications received under the scheme; implementing the scheme and carrying out other responsibilities as assigned by Ministry of Electronics and Information Technology from time to time. The functions and responsibilities of nodal agency will be elaborated in the Scheme Guidelines to be issued by Ministry of Electronics and Information Technology separately.
- 9.3. For carrying out activities related to implementation of the Scheme, nodal agency will *inter-alia*:
- 9.3.1. Receive the applications, issue acknowledgements, and verify eligibility of the applicants for support under the Scheme. Till such time that the Nodal Agency is established, Ministry of Electronics and Information Technology will receive the applications and carry out the further process.

- 9.3.2. Empanel agency(ies) or consultants as deemed necessary to carry out technical and financial appraisal of the projects as well as evaluate expertise of the applicants in these niche areas of Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) and semiconductor packaging.
- 9.3.3. Examine claims eligible for disbursement of fiscal support and incentive under the scheme and disburse those as per eligibility.
- 9.3.4. Submit periodic reports to Ministry of Electronics and Information Technology regarding the progress and performance of the scheme.
- 9.4. Nodal Agency will submit the proposals that have been financially and technically appraised and found eligible to the Ministry of Electronics and Information Technology for taking further action by the competent authority for approval / rejection / modification of the applications.

10. Approval

- 10.1 The applications received under the scheme shall be appraised on an ongoing basis and implementation will continue as per the approvals accorded under the scheme.
- 10.2 Approval to the selected applicants will be accorded by the Competent Authority in Ministry of Electronics and Information Technology and communicated by the Nodal Agency to the applicant.
- 10.3 The Competent Authority for approving incentives for any selected applicant upto ₹100 crore will be Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology. Approval of incentives above ₹100 crore for a selected applicant will be done by Minister of Electronics and Information Technology.

11. Disbursement Process

- 11.1 The incentive against the capital expenditure will be released after the approval of the application, subject to capital expenditure exceeding the threshold value and commencement of commercial production.
- 11.2 Ministry of Electronics and Information Technology shall make budgetary provisions for disbursal of fiscal support to approved projects under the scheme. The disbursement shall be done by the Nodal Agency based on approval conditions. Nodal Agency will submit budgetary requirement to Ministry of Electronics and Information Technology as consolidated amount on regular basis.
- 11.3 The detailed procedure for disbursal to applicants will be laid down in the Scheme Guidelines.

12. Impact Assessment

Mid-term appraisal of the scheme will be done after two years of its implementation or as per requirement to assess the impact of the scheme, off-take by the applicants and economy in terms of the stated objectives. Based on such impact assessment, decision will be taken to increase the tenure of the scheme and change its financial outlay with the approval of the Minister of Electronics and Information Technology.

13. Scheme Guidelines

The scheme guidelines will be issued by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) separately with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

14. **Amendment of Scheme and Guidelines:** The scheme and its guidelines shall be reviewed and amended periodically or as per requirement with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

SAURABH GAUR, Jt. Secy.